



项目编号：20066-2026-QE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川和恩泰半导体有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 颜晔、巫传莲

报告日期： 2026年3月3日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！

## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：颜晔、巫传莲



受审核方名称：四川和恩泰半导体有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	19.01.02,19.02.00
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	19.01.02,19.02.00
B	颜晔	组员	审核员	2025-N1QMS-5096265	
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1EMS-3096265	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张怡羚、黄立刚、罗昌海、马明	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定、《中华人民共和国消防法(2021修正)》(中华人民共和国主席令第81号)、《中华人民共和国环境保护法(2014修订)》(中



中华人民共和国主席令第9号)、《中华人民共和国行政许可法(2019修正)》(中华人民共和国主席令第29号)等等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全标准:《污水综合排放标准》(GB 8978)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、半导体器件注册与标准外形图JEDEC JEP95、半导体器件的机械标准化GB/T 15879、引线键合剪切测试方法JESD22-B116B、非气密表面贴装器件(SMDs)的潮湿/再流焊敏感度分级IPC/JEDEC J-STD-020、印制板的可接受性IPC-A-600M、印制板 第3部分:设计和使用GB/T 4588.3-2022、固态存储性能测试规范SNIA SSS PTS、电子组件的可接受性IPC-A-610M等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2026年03月02日上午至2026年03月03日下午实施审核。

审核覆盖时期:自2025年6月2日至本次审核结束日。

**审核方式:** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**(如与审核计划不一致时,请说明原因):

Q:集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试

E:集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试所涉及场所的相关环境管理活动

与审核计划一致。

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)**

注册地址:四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园5号楼1-5层

办公地址:四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园5号楼1-5层

经营地址:四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园5号楼1-5层

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间):无。

**1.5.4 一阶段审核情况:**

于2026年02月05日09:00至2026年02月05日13:00进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:Q:生产过程控制;E:运行策划和控制;E:绩效测量和监视。

**1.5.5 本次审核计划完成情况:**

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整,调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容,未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容,原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况,或者断电、火灾、洪灾等不利环境):



### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合业务部 QE7.2;

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限：2026年3月13日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年3月3日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：Q：生产过程控制；E：运行策划和控制；E：绩效测量和监视。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理层、员工非常积极配合，提供审核所需要的资料。
- 2、特种设备公司电梯、简单压力容器---安全阀、压力表；公司的计量器具严格按照法规要求进行检定/校准，并且能出具相关校准/检定合格报告。
- 3、严格按照国家法规规定要求，进行环境污染物排放（废气、废水、噪声）检测，能出具有效的环境污染物检测报告。污染物排放符合标准要求。
- 4、公司车间规划布局合理；现场整洁卫生能够提供较好的工作环境。未发生环境污染事件，以及重大质量投诉。
- 5、公司作业文件与公司实际生产经营情况相符，各类指导书、作业文件、检验规范标准等文件资料齐全，能指导引领现场产品生产/检验。
- 6、公司产品检验记录管控好：原材料检验、生产过程检验、产品检验资料齐全，与实际生产相对应。
- 7、公司采用ERP系统对生产现场进行电子化管控，无纸化办公，节能降耗的同时，易于生产管控。
- 8、一般固废：清润模胶/废树脂入库登记明细很清楚。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年3月31日；管理体系实施时间：2025年6月2日



2) 法律地位证明文件有:

公司营业执照2021年3月31日成立,符合要求,有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 管理体系覆盖人数: 179人; 实际购买 179 人社保。公司人员随着生产经营情况, 进行增减人员, 人员有流动性。

倒班情况: 公司有倒班。公司办公室员工白班上班时间, 早上 8:30--11:30; 13:10---18:00; 车间: 倒班人员上班时间: 有倒班, 8 点---20 点, 20 点---8 点。

4) 范围内产品/服务及流程:

集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试生产流程:

送板---锡膏印刷---贴片---回流焊---清洗---固晶---固化---等离子清洗---键合----内部测试---塑封----成型---切割---外观检查---激光打标---开卡---包装入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司主要从事集成电路芯片的封装与测试以及SSD 固态硬盘的SMT 贴片、精密组装、测试; 公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下:

1、管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的质量、环境方向和目标, 同时激励员工专注于质量环境。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 质量方针为: 客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先; 环境方针为: 全员参与、诚信守法、节能降耗、持续改善。 公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标:

质量目标:a) 产品交付合格率 100%; b) 顾客满意率≥95%; c) 产品检验合格率≥98%; d) 产品生产自检合格率≥98%; e) 采购产品合格率 100%; f) 计划培训实施率 100%;

环境目标: 固体废弃物合理处置率 100%; 火灾事故发生次数 0; 降低噪音措施实施率 100%; 管理目标制定合理, 目标均可测量, 抽查 2025 年 6 月--2026 年 1 月管理目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解, 各职能部门的目标分解见各职能部门的审核, 确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系文件的策划: 受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录, 包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息, 编制的体系文件基本符合标准规定的要求, 能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制: 策划的文件控制程序, 均满足公司管理体系需求, 同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更



新，保持了文件和记录的有效性。

3、组织建立组织机构分为：管理层、综合业务部、生产部、产品部、财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

4、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

5、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

6、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025.12.8-12.9 实施了质量、环境管理体系内审，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

7、管理评审：公司于 2025.12.23 实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

8、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

9、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供集成电路芯片的封装与测试以及SSD 固态硬盘的SMT 贴片、精密组装、测试，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、产品设计开发控制：经与负责人沟通确认，公司的道集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试(法规强制要求范围除外)均已定型，产品生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品生产配方过程进行更改改动，所生产流程内容没有进行设计和开发



相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

查,公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

产品设计与开发基本符合要求。

2、供应商管理:对于依赖供应商提供客户需要的产品,需要进行供应商质量管理,公司目前主要供应商,根据客户需求来定,或者客户指定要求产品进行采购,对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价,评价均合格,纳入合格供应商名录。采购过程:1.查采购合同,有效,供方为合格供方。2.查合格供方名录,供方均做了评价,及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等,确保供应商提供的材料和服务。

3、过程监测和绩效评估:通过建立过程监测机制,对产品实现过程中的各项活动进行监测,以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录,检查结果,并进行持续改善。

4、公司管理手册和程序文件运行正常,文件控制符合要求,作业现场未发现作废文件在使用的情况。

5、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育:公司按照2025年公司制定的培训计划,公司定期对员工进行培训教育,适宜时进行了有效性评估。

△现场审核了解到公司内审是在咨询老师指导下完成的,现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况,对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求),不能回答清楚,存在能力不足。

对其开具了一般不符合项,需要公司持续改进。

6、公司主要从事:集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试。

1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括:检验规范、操作指导文件等,均放置于工位附近,便于查阅对照。抽见:锡膏搅拌机作业指导书;锡膏印刷机作业指导书;西门子贴片机作业指导书;劲拓回流焊炉作业指导书;手动植球机作业指导书;植球机作业指导书;SMT 标准作业指导书;DT-F210 植球机作业指导书;炉后外观检验标准;干燥箱作业指导书;锡球使用和储存管控指导书;锡膏管控指导书;SMT 钢网管控指导书;SMT 锡膏回温机作业指导书;植球机保养作业指导书;西门子贴片机保养作业指导书;全自动印刷机保养作业指导书;回流焊炉保养作业指导书;植球工艺规范;SMT 工艺规范;SMT 首件及上料核对作业规范;SMT 工序不良看板;DB 工艺规范;DB OCAP;DB 工治具管理;MAPPING 转化 SOP;氮气烤箱作业 SOP;DB 标准作



业 SOP；装片参数控制表；7S 管理规定；WB 生产流程图；水滴角测量作业指导书；品质奖惩制度；WB 标准作业指导书；WB 工艺规范文件；高倍显微镜作业指导书；WB 补线标准作业指导书；WB 挑线标准作业指导书；等离子清洗机作业指导书；推拉力机操作指导书；ESD 静电量测作业指导书等。

3.现场查看：现场有：UDP 无痕开卡机、制氮机、固晶机、全自动绿激光切割机、植球机、PCBA 清洗机、3T/H 纯水机、上板机、印刷机、等离子清洗机、单门单控精密光电烤箱、单门单控充氮烤箱、塑封压机、测带机、开卡机、冷库、智能氮气柜、切割机、AX 测试版等等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

查特种设备：电梯、压力容器及附件安全阀、压力表。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为：温湿度计、影像测量仪、电子天平、测量显微镜、推拉力器、电子台秤、万用表、推拉力计、静电地桩接地电阻测试仪、测温仪、数显卡尺、带表卡尺、炉温测试仪、人体综合测试仪、表面电阻测试仪、离子风机衰减测试仪、静电测试仪等。

5、集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试生产流程：

送板---锡膏印刷---贴片---回流焊---清洗---固晶---固化---等离子清洗---键合---内部测试---塑封---成型---切割---外观检查---激光打标---开卡---包装入库

关键/特殊过程：焊线（芯片生产）、SMT 贴片（SSD 产品生产）。

服务的提供方（外包）：晶圆切割（划片）、产品物流运输。

6、出示了：生产计划----《工单子计划》明确的产品名称、数量等内容；

查看 2026 年 3 月 2 日《新品封装工单子计划》

工单号：COB-HET-20260302-085730-61122；开始/结束时间：2026-3-3；成品数量：61122；物料总数量:61,122；量产；打线图纸编号：HET20250821B;BOM 类型：芯片封装；产品名称：K9AFGY8J0C-TF；PCB 型号：TF-10-B;容量：32GB；FLASH 贴片数量：1；生产流程环节：贴片，回流焊，外观检查，清洗，烘烤，固晶，烘烤，等离子清洗，焊线，模压前测试，等离子清洗，模压，模压后全测，切割，外观全检，测试，OQC，包装。

单颗 FLASH 容量/状态：K9AFGY8J0C-0.06mm-AK-1B；主控型号：AS2705ENLT；

物料编号	物料型号/名称	数量
WL-007584	TF-10-B	61122
WL-027729	K9AFGY8J0C	61122

。。。。。。等等物料。

2026 年 3 月 2 日生产现场查见：

SMT（印刷贴片） 型号规格：TF-31-G(AY 主控)；操作工胡金艳在全自动印刷机 SMT01 设备上按照《全自动印刷机设备操作规程》和《全自动印刷机作业指导书》对 TF-32-G-PCB 基板进行目检，工艺参数：运输速度:900MM/S 印刷速度:200MM/S，自检合格后转入下一道工序贴片。

DB（固晶） 型号规格：KH25U1635EWOY-TF；操作工李婷婷在 DB03 设备上按照《DB 标准作业 SOP》作业，工艺参数：DAF 贴装温度 135℃，自检合格后转入下一道工序：烘烤。

WB（焊线） 型号规格：0T26-BGA；操作工杨兰在 WB11 设备上按照《WB 标准作业 SOP》作业，工艺参数：合金线产品 N2.H2 流量：0.2~0.6L/min，自检合格后转入下一道工序：MD。

MD（模压） 型号规格：K9AFGD8J0C-UDP3.0；操作工杨佳红在 MD02 设备上按照《模压工艺规范》作业，工艺参数：模压温度：170±5℃；固化时间：110±10S，自检合格后转入下一道工序：后固化。



PS（切割） 型号规格：KH25U1635EW0Y-TF；操作工彭雪梅在 PS02 设备上按照《全自动切割机操作指导书》作业，工艺参数：切割水压力 (Mpa)0.3~0.6 切割水温度<25（℃） ，自检合格后转入下一道工序：TEST。

TEST（测试开卡） 型号规格：3DV7-UDP2.0；操作工刘欢在 UDP 开卡线上按照《UDP2.0 作业指导书》作业，工艺参数/容量设置:256GB 128GB 64GB 32GB 等 ，自检合格后转入下一道工序：包装。

查看 2026 年 3 月 2 日《SSD 工单子计划》

SSD 工单号：SSD-20260302-152512；开始/结束时间：2026-3-3；成品数量：100；物料总数量:12500；试产；SMT-BOM 编号：BOM-20260227112421；SMT-BOM 类型：SSD；产品名称：SSD-S502-M.2 2280-PCIE4.0-MAP1602-SSV8-512GB-4 贴 ； PCB 型 号 号 ； EM162-2280-SS4B-8L8H-VA,HET-1504-20003；RDT 测试温度要求：65--70℃；FLASH 贴片数量：4；通电次数：3；SSD 生产流程环节：SMT,K1,高温 RDT,K2,BIT,K3,QCTEST,QA,包装。

单颗 FLASH 容量/状态：K9AKGY8J0B-BGA-BINI；

物料编号	物料型号/名称	数量
WL-022716	EMI162-2280-SS4B-8L8H-VA,HET-1504-20003	100
WL-002000	C0201-105M-6.3V	1700

。。。。。。等等物料。

生产现场观察，产品正常生产，产品名称为：SSD；现场查见工序：

SMT-SSD（固态硬盘印刷贴片） 型号规格：SSD-S502-M.2 2280-PCIE3.0-MAP1202-N4PA-512GB-3 贴 ；操作工邓鹏在全自动印刷机 SMT02 设备上按照《全自动印刷机设备操作规程》和《全自动印刷机作业指导书》对 MAP1202-N4PA-3 贴产品基板进行目检，工艺参数：运输速度:750MM/S 印刷速度:90MM/S ，自检合格后转入下一道工序 SSD 测试 K1。

SSD-TEST（固态硬盘测试） 型号规格：SSD-S502-M.2 2280-PCIE3.0-MAP1202-N4PA-512GB-3 贴 ；操作工万文丽在 RDT 设备（高温设备）按照《PCIE 高温 RDT 作业指导书》作业，良品外观合格后转入下一道工序 SSD 测试 K3。

关键/特殊过程：焊线（芯片生产）、SMT 贴片（SSD 产品生产）。公司文件对关键/特殊过程的管理进行了规定。对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：2025.6.10 对焊线（芯片生产）、SMT 贴片（SSD 产品生产）工序的《关键过程确认表》

人员资格：操作人员工人按要求经过培训及资格考核合格上岗，满足要求；

设备确认：贴片机、回流焊等设备定期进行检验，设备正常，满足要求；

工艺方法：编制有西门子贴片机作业指导书、SMT 锡膏回温机作业指导书、劲拓回流焊炉作业指导书、SMT 印刷洗板作业规范等，能满足要求、有作业指导书。

确认意见：能满足生产的要求。

确认人：罗昌海、王悦聪 。

关键/特殊过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

提供了发货单--《送货单》：



2026-2-9，产品名称：SSD；数量：3000pcs；规格型号：SSD-S502-M.2 2280-PCIE3.0-MAP1202-N38A-512GB-4 贴；出货单号：XSFH-HNCC-20260209-141143-3000；收货单位：湖南长城计算机系统有限公司。

2026-1-31，产品名称：芯片；数量：20000pcs；规格型号 N38A-TF-64GB-U1，出货单号：XSFH-LK-20260131-090900-2000；收货单位：深圳市朗科科技股份有限公司；

。。。。。

产品交付符合要求。

产品生产过程基本受控，符合要求。

#### 7、产品和服务放行：

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

近一年内，尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

#### 一、原材料检验：

能出示：《SMT 电子元件来料检验》《来料检验标准作业指导书》等文件，文件适宜。

抽查：

- 1、《晶圆来料检验记录表》客户：HET；2025.9.6；
  - 2、《PCB 来料检验记录表》2025.9.5；供应商：IEX；
  - 3、电阻、电容、二极管来料检验记录表：
- 等等原材料检验记录均符合要求。

#### 二、集成电路芯片的封装与测试生产过程检验记录和 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试生产过程、成品检验：

出示：《HET-WI-157 Rev A.0 SSD 产品抽样检验操作指导书》、《HET-WI-166 Rev A.1 制程检验流程》、《WI-QC-003 Rev A.0 SSD 首件检验作业指导书》等等。

抽 1：

《SMT 首件确认单》生产型号：PCS3.0；工单数量：317（18pcs 空板） 检验日期：2025.11.8；Flash 信息：N38A/3DV6/EMS；主控信息：MAP1202；生产线体：L1；制程首件；工程、生产、品质确认签字合格。

《SMT 首件确认单》生产型号：HETYSP2-SG-CYS-S-005-00-SATA3；工单数量：1000 检验日期：2025.12.4；Flash 信息：N38B；主控信息：YS9085A；生产线体：22；制程首件；工程、生产、品质确认签字合格。

抽 2：《DB 首件送检记录表》日期 2025.12.25 白；客户：PSTK；产品型号：2G28AD-TF；COB 流程单号：20251223-091747-141330；送检数量：47；送检时间：8：06；OP 送检人；完成时间：8：20；判定结果：OK；品质确认签字。

《DB 首件送检记录表》日期 2025.12.25 白；客户：HET；产品型号：LY3202-SSD 15#；COB 流程单号：20251224-165741-45130；送检数量：46；送检时间：8：17；OP 送检人；完成时间：8:26；判定结果：OK；品质确认签字。

日期 2025.12.25 夜；客户：HET；产品型号：3DV8-BGA 7#；COB 流程单号：20251225-103040-3846；送检数量：47；送检时间：20:24；OP 送检人；完成时间：20:46；判定结果：OK；品质确认签字。

《DB 首件送检记录表》



日期 2025.12.5 白；客户：HET；产品型号：8T20-MUDP3.0 8#；COB 流程单号：20251204-135700-42623；送检数量：48；送检时间：8:12；OP 送检人；完成时间：28:22；判定结果：OK；品质确认签字。

日期 2025.12.5 白；客户：PSJK；产品型号：CBM3280 18#；COB 流程单号：20251202-161554-20233；送检数量：48；送检时间：8:15；OP 送检人；完成时间：8:24；判定结果：OK；品质确认签字。

日期 2025.12.5 白；客户：HCT；产品型号：AY2705ENLFBC 17#；COB 流程单号：20251204-095110-6233-42623；送检数量：47；送检时间：8:16；OP 送检人签字确认；完成时间：8:26；判定结果：OK；品质确认签字。

日期 2025.12.5 白；客户：PSJK；产品型号：TT23--TF 13#；COB 流程单号：20251202-152822-22803；送检数量：45；送检时间：8:07；OP 送检人；完成时间：8:28；判定结果：OK；品质确认签字。

日期 2025.12.5 白；客户：HET；产品型号：8AHB-BGA 4#；COB 流程单号：20251203-171148-12969；送检数量：47；送检时间：8:16；OP 送检人；完成时间：8:32；判定结果：OK；品质确认签字。

抽见：《QC 检查记录表（固晶站）》

日期	机台	客户	流程单号	产品类型	核对晶圆（型号、BIN 级、厚度 mm、数量）			
2025.12.16	8#	HET	20251208-094738-135577	BGA	N49A	0.05	480	
BGABE202504-N4PA								
2025.12.16	5#	HET	20251208-094738-135577	BGA	N49A	0.05	480	
BGABE202504-N4PA								
2025.12.16	4#	HET	20251208-094738-135577	BGA	N49A	0.05	480	
BGABE202504-N4PA								

检查时间：9:00

目检项目：（固晶位置、芯片破损、翘高、胶堆高（10--90%）粘胶、产品方向、晶圆表面、金手指/油墨）有无首检等；

检查结果：ok。

IPQC 签字确认。

抽：《SSD 测试检验记录表》

日期	班次	生产批次	产品型号	读写速度（读、写）	固件版本	容量	通电次数	温度
2025.12.31	白		SSD-20251228-145356		SSD-S503-M-2-2280-SATA3-2			
YS9085N-SSV6-128GB-2185								
549.03\48635	HT3C0987	128GB	1 次	31°C	/	ok		
2025.12.31	白		SSD-20251228-145356		SSD-S503-M-2-2280-SATA3-2			
YS9085N-SSV6-128GB-2185								
507.78\479.85	HT3C0987	128GB	1 次	38°C	YS202412295802HP			ok

检验员：悦签字确认。

另抽：2025 年 6-2026 年 1 月《SSD 测试检验记录表》记录 10 份，过程检验记录均符合要求。



抽：《SMT 材料上（换）料记录表》

材料名称：SSD-S502-M.2-2280-PCLE3.0

MAP 1202.N38A-256GB-2 贴

日期：2026-1-3； 白班 线体：L2 批量：25200

IPQC 核对签字确认。

另抽：2025 年 6-2026 年 1 月《SMT 材料上（换）料记录表》集成电路芯片和 SSD 记录各 10 份，过程检验记录均符合要求。

抽：《WB 品质检验记录》

产品基础信息：日期/时间:01.30 Flash 型号:N38A 产品类型 BGA、UDP\TF\半 SD:TF ;封装结构 SDP: 芯片 1; DDP:2;QOP: 3; OOP:4;流程单号:1; 小单号:095942--97928 机台号:33 检验时机:D

不良项目（首件一个焊线窗口，其他 1 条）--不良数量：6；焊线位置（改机确认）--记录不良数量：6；

焊线拉力（3 根线）--记录测量拉力数据：6.4；6.5；6.4； 无异常。

焊线大小（3 个球）记录测量直径数据：32；32；33；无异常；

焊线厚度（3 个球）：记录测量焊线厚度数据：13；15；15 无异常；

焊线高度（3 个球）：记录测量焊线高度数据：86；126；136 无异常；

最终结果：合格

检验员：吴某。

抽：《IPQC 巡检记录表（模压站）》日期 2025.12.30

机台 客户 产品型号 巡检时机 塑封料型号 胶饼是否过期 模具型号确认 清洁（上模/下模）

全 HET KH25H8033FW8Y-TF 10:00 14\*4.9 √ TF √ √

模穴位置 模具型号/厚度 目检项目（粘模、无脏污、不完全填充、气孔、胶体划伤、金手指划伤、基板凹坑）等

√ 0.70；0.71；0.71；0.71 √

巡检员：刘某。

抽：《IPQC 巡检记录表（尺寸）》班次:A；日期：2025-12-30；时间：12：00；机台：125jk；产品型号：2G28AD-6322-TF；尺寸测量位置 mm（长、宽、金手指宽度（TF）；厚度）15:01;10:98;9.74;0.71

集成电路芯片的封装与测试生产过程均按检验规范/作业指导书要求进行了检验，基本符合要求。

SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试生产过程、成品检验均按检验规范/作业指导书要求进行了检验，基本符合要求。

● 集成电路芯片的封装与测试成品检验，按 HET-WI-167 Rev A1 成品抽样及出货检验规范标准进行检验，详细如下：

抽：《产品检验记录表》

日期：2025.12.31；

产品型号：2u28AP-6322-TF 128MB;送检数量：3000；检验数量：360；送检员、检验员均签字确认。批次号：PSJK 091651--27332 批次：192014 AX215DA;1117(V25)

产品型号：2u28AP-6322-TF 256MB;送检数量：3000；检验数量：360；送检员、检验员均签字



确认。批次号：PSJK 091747--141330 批次：192014 AX215DA;1117(V25)

另抽：集成电路芯片的封装与测试《产品检验记录表》10份；均符合要求。

● 查 2025 年度产品委外检测报告：

1、提供有：SGS 出具的产品委外检测报告：报告编号：CKGEC25001020301;2025 年 7 月 29 日；产品 TF；参考信息：LGA、UDP2.0、MUDP2.0、半 SD；检测单位：SGS，检验结论：符合标准技术要求。

2、提供有：SGS 出具的产品委外检测报告：报告编号：CKGEC25001020302;2025 年 7 月 29 日；产品 TF；参考信息：LGA、UDP2.0、MUDP2.0、半 SD；检测单位：SGS，检验结论：符合标准技术要求。

3、提供有：SGS 出具的产品委外检测报告：报告编号：CKGEC25001020303;2025 年 7 月 29 日；产品 TF；参考信息：LGA、UDP2.0、MUDP2.0、半 SD；检测单位：SGS，检验结论：符合标准技术要求。

4、提供有：SGS 出具的产品委外检测报告：报告编号：CKGEC25000827501;2025 年 6 月 24 日；产品 SATA；参考信息：Pcie series、SATA series；检测单位：SGS，检验结论：符合标准技术要求。

5、提供有：SGS 出具的产品委外检测报告：报告编号：CKGEC25000827401;2025 年 7 月 29 日；产品 SATA；参考信息：Pcie series、SATA series；检测单位：SGS，检验结论：符合标准技术要求。

具体检验内容见上传附件。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司产品检验基本符合要求，受控。。

6、查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购、生产、检验、销售，原材料时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原材料，能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

**管控措施：**

一、废水：

公司用水主要包括员工办公生活用水和生产用水(清洗和切割用水)，生产车间地面用清扫灰尘，无



地面清洗废水，外排废水主要为办公生活污水、清洗切割废水以及纯水制备废水。

清洗切割废水经自建沉淀池沉淀处理后与办公生活污水、纯水制备废水一并排入恩彼特智能制造产业园已建预处理池(有效容积:40m<sup>2</sup>)，经处理后排入市政污水管网，经城南第二污水处理厂处理达标后尾水排入涪江。

## 二、废气：

公司废气主要为回流焊产生的废气(焊接烟尘、有机废气)、激光打标烟尘、激光切割烟尘、固化有机废气、塑封成型有机废气以及固化过程中产生的氨。

### 1、回流焊废气(焊接烟尘、有机废气)

公司回流焊接采用无铅免洗焊锡膏，回流焊工序产生的废气主要包括焊接烟尘、有机废气，焊接烟尘主要成分为锡及其化合物，回流焊废气(有机废气和焊接烟尘)经设备抽风管收集后汇入末端设置的1套“聚酯纤维过滤芯+二级活性炭吸附”装置，经处理后通过1根25m高(P1)排气筒。

### 2、光切割烟尘

利用激光切割机对PCB板进行切割，切割过程中会产生切割烟尘，激光切割烟尘经抽风管收集后与其他工序产生废废气一并汇入末端设置的1套“聚酯纤维过滤芯+二级活性炭吸附”装置，经处理后通过1根25m高(P1)排气筒。

### 1、激光打标烟尘

公司在激光打标过程中会产生烟尘污染，激光打标烟尘经收集后与其他工序产生废废气一并汇入末端设置的1套“聚酯纤维过滤芯+二级活性炭吸附”装置，经处理后通过1根25m高(P1)排气筒。

### 4、固化有机废气

公司为进一步将芯片粘合在PCB板上，需将经固晶后的PCB板送入烤箱进行固化，固化过程中会产生少量有机废气，固化有机废气经烤箱设置的软管收集后与其他工序产生废废气一并汇入末端设置的1套“聚酯纤维过滤芯+二级活性炭吸附”装置，经处理后通过1根25m高(P1)排气筒。

### 5、塑封、成型有机废气

塑封、成型有机废气主要来源于环氧树脂塑封料加热后挥发产生，废气经设备上方设置的抽风管收集后与其他工序产生废废气一并汇入末端设置的1套“聚酯纤维过滤芯+二级活性炭吸附”装置，经处理后通过1根25m高(P1)排气筒。

### 6、模具清洁有机废气

经塑封后的模具上沾有少量环氧树脂，利用清模润胶条进行软化清洁，清模润胶条在电加热软化过程中会产生少量有机废气，废气经设备上方设置的抽风管收集后与其他工序产生废废气一并汇入末端设置的1套“聚酯纤维过滤芯+二级活性炭吸附”装置，经处理后通过1根25m高(P1)排气筒。

## 三、噪声：

公司噪声主要来源于印刷机、贴片机、模压机、激光切割机、切割机、激光打标机、空压机、风机等机械设备。

项目通过选用低噪设备、设备基础减振，合理布置产噪设备、厂房隔声、距离衰减，合理安排生产时间，项目仅昼间生产，夜间不生产，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，



杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象等措施来降低噪声对周围环境的影响。

#### 四、固体废弃物：

公司的固体废弃物主要为一般固体废物和危险废物，其中一般固废包括废包装材料、废钢瓶、纯水制备产生的废活性、废离子交换树脂、废反渗透膜、废石英砂、废消润模胶条、废过滤器、办公生活垃圾和预处理池污泥等，危险废物为废胶管、废 PCB 板边角料、沉淀池沉渣以及废气治理设施产生的废活性炭、废滤芯等。

废包装材料：交废品收购站回收；

废钢瓶、纯水制备产生的废活性、废离子交换树脂、废反渗透膜：交厂家回收处置。

废石英砂、废消润模胶条、废过滤器：交废品收购站回收；

办公生活垃圾：交环卫部门清理处置。

预处理池污泥：由恩波特智能制造产业园清掏后交换位部门清运处置。

危险废物为废胶管、废 PCB 板边角料、沉淀池沉渣以及废气治理设施产生的废活性炭、废滤芯等：暂存于危废暂存间内，定期交由第三方有资质的单位进行处置。

能查见公司与有资质的第三方油诺客环保科技有限公司签订了危废处置协议，协议有效，符合要求。

查见《危废登记台账》公司 2024 年 12 月 31 日处置了一批危废，但是 2025 年至今未进行处置过，危废堆放在库房内，能出示危废出入库登记明细。

抽见 2025-11-28 14:16 废 PCB 边角料 入库 40kg，塑料袋装保存，容量个数:6；存储位置：4-11 仓库；废物转运部门/人员均签字确认。

抽见 2026-2-12 14:20 废 PCB 边角料 入库 22kg，塑料袋装保存，容量个数:10；存储位置：4-11 仓库；废物转运部门/人员均签字确认。

.....

目前库房堆放危废合计 69kg，未满 1 吨，暂未处置，符合企业实际经营需求。

#### 五、潜在火灾：公司执行应急预案，定期进行消防演练。定期进行消防安全检查。

环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

公司制定并实施《合同评审控制程序》，综合业务部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与生产服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1、客户名称：深圳市芯科睿电子科技有限责任公司，签订日期：2025 年 4 月 12 日；产品名称：BGA。



合同内容：产品相关信息、数量、金额、技术要求标准、交货时间地点、交货方式、结算、双方权责利等。

2、客户名称：东莞科易芯科技有限公司，签订日期：2025年4月16日；产品名称：集成电路；合同内容：产品相关信息、数量、金额、技术要求标准、运输方式、验收、结算、双方权责利等。

3、客户名称：深圳市深荣芯电子有限公司，签订日期：2025年3月27日；产品名称：计算机外部设备+存储卡，数量：10000套。；合同内容：产品相关信息、数量、金额、技术要求标准、运输方式、验收、结算、双方权责利等。

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

跟踪抽查公司销售服务合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式、确认提供及时的产品供应、产品的质量、保证提供的产品能满足客户要求等，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试。

基本符合。

经查：近年以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

公司 2025 年 12 月以满意度调查表的形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 5 份，回收 5 份。对公司的服务质量、服务期、服务态度、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 96 分。

提供顾客满意调查分析报告，调查总结：这次调查，顾客基本能够达到满意程度。为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织销售服务人员对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的产品，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对计量器具的检定情况进行验证，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

公司暂无环境检测设备。

提供有2025年1月-至今《月度环境检查表》检查记录：着装控制、管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌、应急物资；检查结果：符合规定要求。



提供有《2025年度监测报告》，编号：四川科正（环）检字（2025）第298901号；日期：2026.1.6；  
监测项目：废气、噪声、废水，结果：满足要求。

部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门管理目标完成情进行分析，确定管理体系运行状况，对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度。

对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定管理体系的有效性。

部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理体系的持续改进。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。2025.12.8-12.9实施了质量、环境管理体系内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025.12.23进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

公司自开展质量环境管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工



作效率，增强了风险的管理。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对产品生产过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

存在的差距：

### 1. 产品质量差距

产品质量差距是指企业实际生产的产品质量与预期质量目标之间的差异。这种差距可能源于设计缺陷、生产过程中的质量控制不足、原材料质量不稳定或员工操作技能欠缺等因素。

### 2. 服务质量差距

服务质量差距涉及企业提供的服务与客户期望之间的差异。根据服务质量差距模型，这种差距可能出现在五个层面：管理层对客户期望的理解不足、服务质量标准与客户期望不匹配、实际服务交付未达标准、服务承诺与实际表现不一致，以及客户感知的服务质量与预期不符。

### 3. 管理质量差距

管理质量差距体现在企业战略执行、资源配置和内部沟通等方面。许多企业在战略规划与执行之间存在脱节，导致资源浪费和效率低下。

改进机会：

### 1 优化流程与资源配置

针对流程低效或资源分配不合理导致的绩效差距，企业应优化工作流程，重新分配资源以提高效率。

### 2 提升员工技能与激励机制

员工技能不足和激励缺失是导致绩效差距的重要原因。企业应通过内部培训计划、导师制度和持续学习机会，提升员工的专业技能和职业素养。

### 3 强化客户反馈与市场调研

通过客户反馈和市场调研，企业可以更准确地理解客户期望，识别服务质量差距。定期进行客户满意度调查和一对一访谈，收集客户对服务质量的直接反馈，可以帮助企业及时调整服务策略，提升客户体验。

## 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园 5 号楼 1-5 层

审核地址：四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区纵一路恩彼特智能制造产业园 5 号楼 1-5 层；

基础设施：公司恩彼特智能制造产业园 5 号楼整栋楼，一共 5 层；第 1-2 层为生产车间；第 1 层有 WB 车间、模压车间；第 2 层有 SMT 车间（SMT 贴片、SSD 组装、测试）、DB 车间；第 3 层为测试车间（SSD、



DDR、内存条、U 盘、芯片、BGA 颗粒等测试）；第四层用于仓库；第 5 层用于办公及会议室。

配置了办公所用的电脑、手机、打印机、网络等齐全。

配置了生产设备：UDP 无痕开卡机、制氮机、固晶机、全自动绿激光切割机、植球机、PCBA 清洗机、3T/H 纯水机、上板机、印刷机、等离子清洗机、单门单控精密光电烤箱、单门单控充氮烤箱、塑封压机、测带机、开卡机、冷库、智能氮气柜、切割机、AX 测试版等。

日常沟通工具：微信、电话、电子邮件等；

测量仪器设备：温湿度计、影像测量仪、电子天平、测量显微镜、推拉力器、电子台秤、万用表、推拉力计、静电地桩接地电阻测试仪、测温仪、数显卡尺、带表卡尺、炉温测试仪、人体综合测试仪、表面电阻测试仪、离子风机衰减测试仪、静电测试仪等。

配置了环境设备设施：废气处理装置、灭火器、垃圾桶、消防栓等。

特种设备：电梯、压力容器及附件安全阀、压力表。

公司无食堂、无宿舍。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试所涉及场所的相关质量、环境管理活动的需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境情况，通过媒体了解环境要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 5) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到



控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试

E:集成电路芯片的封装与测试以及 SSD 固态硬盘的 SMT 贴片、精密组装、测试所涉及场所的相关环境管理活动

#### 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现，审核组一致认为，深圳锐驰物联科技有限公司的

质量管理体系 环境管理体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、颜晔、巫传莲



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。